n8 Aug 2004

BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY

OCUMENT

ITTED OR TRANSMITTED IN
ANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



PCT / IB 04 / 0 2 5 4 3

MOU. C.L. -

MAILED: 18 AUG 2004

WIPO PCT

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Ufficio G2

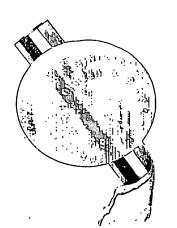
10,33 Euros

Autenticazione di copia di documenti relativi alla domanda di brevetto per: INVENZIONE INDUSTRIALE N. TO 2003 A 000605 del 05.08. 2003

Si dichiara che l'unita copia è conforme ai documenti originali depositati con la domanda di brevetto sopra specificata, i cui dati risultano dall'accluso processo verbale di deposito.

≥4 A60.2004

Roma, li.....



IL FUNZIONARIO

Giampietro Carlotto

PIUL STO LOUDIO

MODULO A (1/2)

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (U.I.B.M.)

DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALEN 2003 A 0 0 0 6 0 5

A. RICHIEDENTE/I													G. 47	AGO/A
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1	C.R.F.	SOCIET/	A CONSC	ORTILE P	ER AZION	п				NI.	NIST	C/\	AGRICOUN,
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2	PG		FISCALE TA IVA		0708456	0015	-		·		-,0.6		1010
INDIRIZZO COMPLETO	A4	STRAD				RBASSANO	TI) OT C	ALIA)	-					
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	A1	<u></u>									IRE 100-	mar L		cent .
NATURA GIURIDICA (PF/PG)	A2			FISCALE TA IVA						(Constitution)		1		
INDIRIZZO COMPLETO	A4	<u> </u>	1 * 1 * 1 * 1 * 1	174 2 7							D IO			W
A. RECAPITO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI MANDATARIO	во		(D = I	ЮМІСІL	IO ELETT	TVO, R=	Rappres	SENTANTE)) .		¥000.	31111	3.Eury	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	B1	L									V	A9 'A		
NDIRIZZO	B2							,						
CAP/LOCALITÀ/PROVINCIA	В3													
C. TITOLO	Cı	1	EDIMENT	ro di fa	BBRICAZ	IONE DI C	DISPOSITI	VI DI RILEV	'AZION	NE DI C	AMPI MAG	NETICI E	RELATIV	5
D. INVENTORE/I DESIGNAT	O/I	(DA IN	DICAR	E ANC	HE SE I	'INVEN	TORE C	OINCID	E CO	V IL R	CHIEDE	NTE)		
COGNOME E NOME	D1	PULLI	VI DANIE	:LE				-					 .	
Nazionalità	D2	ITALIA	NA											
COGNOME E NOME	D1	MART	MARTORANA BRUNETTO											
Nazionalità	D2	ITALIA	ITALIANA											
COGNOME E NOME	D1	PERLO	PERLO PIERO											
Nazionalità	D2 -	ITALIA	NA											
COGNOME E NOME	D1							 						 -
Nazionalità	D2						•							
	SEZ	ZIONE		Cı	.ASSE		Sorre	OCLASSE			RUPPO	·	Som	TOGRUPPO
E. CLASSE PROPOSTA	E1		<u></u>	E2			E3			E4			E5	
F. PRIORITA'		DERIVA	NTE DA PF	RECEDENT	TE DEPOS!	TO ESEGUT	TO ALL'ES	TERO						
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1										Tipo	F2		
Numero di Domanda	F3		 -						$\dashv_{\scriptscriptstyle \rm I}$	DATA I	DEPOSITO	F4	·	
STATO O ORGANIZZAZIONE	F1							···	+		TIPO	F2		
NUMERO DI DOMANDA	F3								-	ΌΑΤΑ Ι	DEPOSITO	F4		
G. CENTRO ABILITATO DI												<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RACCOLTA COLTURE DI	G1		/	$/\!\!/$										
MICROORGANISMI FIRMA DEL/DEI	120	Glav	ncarlø.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	420									
RICHIEDENTE/I		N. 18	ncario. criz. Ay roe be	6 d /258	ARO Silinii									

•			M	OD	UL	O A	(2/2	2)		
IANDATARIO DEL RICHIE E SOTTOINDICATA/E PERSONA/E HA/I JANO BREVETTI E MARCHI CON L'INCA	HANN RICO	O ASSUNTO II DI EFFETTUAR	E TUTTI	ATO A GLI A	RAP	D ESSA C	.ONI			
IMERO ISCRIZIONE ALBO	I1							O; N. ISCR. ALBO 259 BUZZI FRANCO;		
GNOME E NOME;		N. ISCR. ALBO 260 BOSOTTI LUCIANO; N. ISCR. ALBO 507 MARCHITELLI MAURO;								
		N. ISCR. AL	BO 335	SER	TOL	GIOVAN	INI			
:NOMINAZIONE STUDIO	I 2									
DIRIZZO	I 3	3 VIA MARIA VITTORIA, 18								
\P/Località/Provincia	I4	10123 TORI	NO - TC							
ANNOTAZIONI SPECIALI	L1							·		
. DOCUMENTAZIONE ALI	.EG	ATA O CO	ON RI	SER	VA	DI PR	ES	ENTAZIONE		
TIPO DOCUMENTO		N.Es.AIL	N. Es	. Ris	•	N. PAG.	. PEF	R ESEMPLARE		
OSPETTO A, DESCRIZ., RIVENDICAZ.	Γ	2			7 [17				
BBLIGATORI 2 ESEMPLARI) SEGNI (OBBLIGATORI SE CITATI IN	\vdash	2			-	3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SCRIZIONE, 2 ESEMPLARI)	<u> </u>				1			j		
ESIGNAZIONE D'INVENTORE	L				4					
CUMENTI DI PRIORITÀ CON ADUZIONE IN ITALIANO					_					
UTORIZZAZIONE O ATTO DI CESSIONE	L		L							
	_	(SI/NO)								
ETTERA D'INCARICO	L	sì						•		
ROCURA GENERALE		NO				•				
FERIMENTO A PROCURA GENERALE	Γ	NO								
· .	(LIRE/EURO)					T	MPORTO VERSATO ESPRESSO IN LETTERE		
TTESTATI DI VERSAMENTO		€	CENTO	OTTA	NTC	OTTO/5	1 (€	188,51)		
OGLIO AGGIUNTIVO PER I SEGUENTI ARAGRAFI (BARRARAE I PRESCELTI)	. .	A	D	İ	F					
EL PRESENTE ATTO SI CHIEDE COPIA UTENTICA? (SI/NO)		Sì					_			
CONCEDE ANTICIPATA ACCESSIBILITÀ	.	NO								
L PUBBLICO? (SI/NO) PATA DI COMPILAZIONE	F		07/0	8/200	03					
IRMA DEL/DEI	ing	. Glancarl	o/Nø	TAF	ίÖ					
ICHIEDENTE/I	!1	N. Iscriz.	ABO 2	glin 8	,					
			VER	ВА	LE	DID	ΕP	OSITO		
NUMERO DI DOMANDA		- 70	2	0	0:	₹ A	n	00605		
	\perp	ORINO				<u> </u>		Cop. 01		
C.C.I.A.A. D	<u> </u>			¥-	/T 70-			/i Sopraindicato/i Ha/Hanno Presentato a me		
In Data	L_	/08/2003		1				•		
LA PRESENTE DOMANDA C	ORRE	data di N.		FOC	SLI AC	GGIUNTI	VI P	ER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO SOPRARIPORTATO.		

NUMERO DI DOMANDA

C.C.I.A.A. DI

IN DATA

05/08/2003

IL/I RICHIEDENTE/I SOPRAINDICATO/I HA/HANNO PRESENTATO A ME

LA PRESENTE DOMANDA CORREDATA DI N.

FOGLI AGGIUNTIVI PER LA CONCESSIONE DEL BREVETTO SOPRARIPORTATO.

V. ANNOTAZIONI VARIE

DELL'UFFICIALE ROGANTE

TIMBRO

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIPERTIGIAPPATOE AGRICOITURA

CATEGORIA C

CATEGORIA C

PROSPETTO MODULO A DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

SEZIONE

CLASSE

SOTTOCLASSE

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

E. CLASSE PROPOSTA

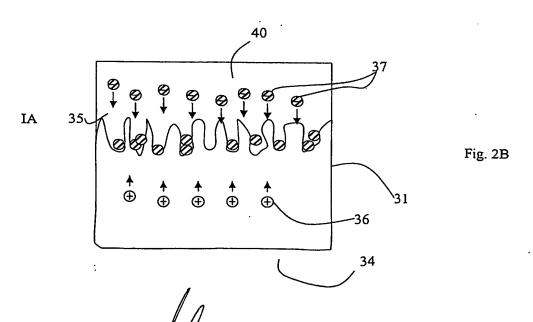
O. RIASSUNTO

PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DI CAMPI MAGNETICI, DETTO PROCEDIMENTO COMPRENDENDO LE OPERAZIONI DI FABBRICARE UN ELEMENTO MAGNETORESISTIVO (10; 20) COMPRENDENTE REGIONI A CONDUZIONE METALLICA (13; 23). E REGIONI A CONDUZIONE SEMICONDUTTIVA (11; 31). DETTO PROCEDIMENTO COMPRENDE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- FORMARE DELLE NANOPARTICELLE METALLICHE (37) PER REALIZZARE DETTE REGIONI A CONDUZIONE METALLICA (13; 23);
- PROVVEDERE UN SOTTOSTRATO DI SEMICONDUTTORE (31);
- APPLICARE DETTE NANOPARTICELLE METALLICHE (37) A DETTO SOTTOSTRATO DI SEMICONDUTTORE (31) PER OTTENERE UNA STRUTTURA MESOSCOPICA DISORDINATA.

(FIGURA 2B)

P. DISEGNO PRINCIPALE



FIRMA DEL/DEI

RICHIEDENTE/I

Ing. Glancerlo MOTARO
N. iscriz/Africo/758

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di: C.R.F. Società Consortile per Azioni, nazionalità italiana, Strada Torino 50, 10043
Orbassano TO

Inventori designati: PULLINI Daniele; MARTORANA
Brunetto; PERLO Piero

Depositata il: 05 Agosto 2003 **10** 2003 A 000605

TESTO DELLA DESCRIZIONE

La presente invenzione riguarda un procedimento di fabbricazione di un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, detto procedimento comprendendo le operazioni di fabbricare un elemento magnetoresistivo comprendente regioni a conduzione metallica e regioni a conduzione semiconduttiva.

E' noto nello stato dell'arte impiegare, al fine di rilevare campi magnetici, dei sensori magnetoresistivi, ovverosia dispositivi la resistenza al passaggio della corrente elettrica varia al variare del campo magnetico a cui vengono sottoposti. In particolare, sono noti magnetici detti AMR (Anisotropic Magneto

Resistance), usualmente realizzati attraverso un film sottile di ferro-nichel (permalloy), depositato su un wafer di silicio e sagomato in forma di striscia resistiva.

L'applicazione di un campo magnetico esterno determina una variazione dell'orientamento della magnetizzazione nel permalloy, rendendo la sua magnetizzazione non parallela alla corrente che fluisce nella striscia resistiva e aumentando quindi la resistenza. Detti sensori AMR cambiano la propria resistenza del 2-3% in presenza di campi magnetici. Al fine di poter apprezzare efficacemente la variazione di resistenza, i sensori AMR vengono quindi depositati in modo da formare un ponte di Wheatstone.

La variazione di resistenza è pero legata all'instaurarsi dell'effetto magnetoresistivo, presente in una limitata quantità di materiali analoghi al permalloy.

tali facilmente Inoltre sensori non sono miniaturizzabili. Dal brevetto integrabili е statunitense No. U.S. 6,353,317 è noto impiegare una struttura di semiconduttore poroso per creare dei nanofili o nanotubi, che vengono successivamente riempiti di materiale magnetico. In figura 1 è

illustrato un elemento magnetoresistivo 10, facente parte di un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, indicato nel suo complesso tramite il riferimento 15, ottenuto tramite deposizione metallo nei pori di un semiconduttore poroso. Tale magnetoresistivo 10 comprende sottostrato di semiconduttore 11, nel quale sono presenti dei pori 12. All'interno dei pori 12 sono presenti dei cilindri 13 di materiale metallico. Al sottostrato di semiconduttore 11 sono applicati elettrodi laterali 14. Il sottostrato semiconduttore 11 è costituito da un semiconduttore ad altà mobilità, ad esempio InAs. Il funzionamento del dispositivo 15 è il seguente.

Agli elettrodi laterali 14 viene applicata una tensione V atta a determinare una corrente I, che fluisce fra gli elettrodi 14 ed il cui valore è dalla resistenza dell'elemento determinato 10. resistenza magnetoresistivo Detta ai sostanzialmente dovuta flussi di corrente attraverso i cilindri 13 metallici, che resistenza più bassa.

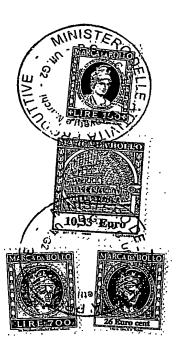
In presenza di un campo magnetico esterno H, nei cilindri 13 si realizza, a cagione della forza di Lorentz, una distribuzione di carica spaziale che

determina un campo elettrico tendente a escludere il passaggio di corrente al loro interno. Pertanto il valore della corrente I che fluisce nell'elemento magnetoresistivo 10 è determinato dalla resistenza del sottostrato di semiconduttore 11, che è più elevata. Inoltre, in esso i cammini elettronici sono ciò contribuisce lunghi piu' tortuosi е all'aumento di nell'elemento resistenza 10. Dunque il dispositivo di magnetoresistivo rilevamento 15 permette di rilevare un magnetico H tramite la brusca variazione, particolare il brusco aumento in presenza del campo della resistenza dell'elemento magnetico Η, magnetoresistivo 10.

Il materiale semiconduttore poroso che costituisce il sottostrato 11 è prodotto tramite una tecnica di reactive ion etching applicata a un wafer di semiconduttore, mentre il metallo che costituisce i cilindri 13 nei pori 12 viene depositato a mezzo di un procedimento di deposizione elettrochimica.

Un simile procedimento tuttavia è abbastanza complesso e costoso, coinvolgendo un processo di reactive ion etching per la creazione di isole conduttive nel semiconduttore.

La presente invenzione si prefigge lo scopo di



realizzare una soluzione in grado di fabbricare un dispositivo di rilevazione di campi magnetici comprendente regioni a conduzione metallica e regioni a conduzione semiconduttiva in maniera semplice e economica.

Secondo la presente invenzione, tale scopo viene raggiunto grazie ad un procedimento avente le caratteristiche richiamate in modo specifico nelle rivendicazioni che seguono.

L'invenzione verrà descritta con riferimento ai disegni annessi, forniti a puro titolo di esempio non limitativo, in cui:

- la figura 1 rappresenta uno schema di principio di un dispositivo di rilevamento di campi magnetici;
- le figure 2A, 2B e 2C rappresentano dei passi di un procedimento di fabbricazione di un dispositivo di rilevamento di campi magnetici secondo l'invenzione.

L'idea alla base del procedimento secondo l'invenzione è di realizzare l'elemento magnetoresistivo del dispositivo di rilevazione di campi magnetici tramite una struttura mesoscopica disordinata di nano particelle metalliche in un sottostrato semiconduttore a alta mobilità e band

gap stretto.

E' proposto, con riferimeno alle figure 2A, 2B e 2C perciò un procedimento di fabbricazione di un elemento magnetoresistivo 20 analogo per scopi e funzionamento all'elemento magnetoresistivo 10, mostrato in figura 1. Tale procedimento in un primo passo prevede di preparare delle nanoparticelle o cluster di materiale metallico, tramite un processo di sintesi di colloidi metallici o altro processo noto di sintesi di nanoparticelle metalliche. particelle nanometalliche, indicate con il riferimento 37 in figura 2B, alternativamente, sono anche disponibili in commercio e possono essere semplicemente acquistate.

In un secondo passo del procedimento di fabbricazione proposto tali nanoparticelle metalliche vengono inserite unite ad un opportuno solvente in una soluzione 40. Il solvente può essere a titolo d'esempio glicole o acetone.

Un terzo passo del procedimento proposto prevede di rendere poroso un sottostrato di materiale semiconduttore 31. In una versione preferita, un template 38 di allumina anodizzata è applicato in di funzione maschera sulla superficie sottostrato semiconduttore 31. Detto template di

allumina anodizzata 38 è provvisto, in virtù del processo di anodizzazione a cui è stato sottoposto, di pori nanometrici 39, sicchè è possibile eseguire successivamente degli attacchi acidi o etching spazialmente selettivi, in particolare tramite un attacco acido di tipo elettrochimico, attraverso i pori 39 del template 38 di allumina anodizzata.

In particolare, una corrente IA viene fatta passare attraverso una soluzione elettrolitica 32 acida tra detto sottostrato di semiconduttore 31, contatto posteriore provvisto di un costituisce l'anodo, e un filamento di platino 33, che costituisce il catodo. Nella soluzione il trasporto di carica può avvenire solamente se all'interfaccia elettrolita/semiconduttore si ha un passaggio di carica tra uno ione della soluzione elettrolitica 32, indicato con il riferimento 35 in figura 2A, e ioni 36 positivi del sottostrato 31 di silicio. Ciò avviene mediante una reazione chimica l'anodo. specifico il che dissolve nel caso sottostrato 31 di semiconduttore. In consequenza di ciò dei pori 22 si sviluppano in profondità nel sottostrato 31 dissolvendolo parzialmente.

In una versione preferita del procedimento tale attacco acido viene eseguito fino a ottenere dei

10.33 Euro

pori 22 passanti attraverso l'intero volume del sottostrato 31 di semiconduttore.

E' possibile impiegare anche altre maschere nanoporose in luogo dell'allumina, quali polimetilacrilato (PMMA) o polimidi.

Un quarto passo del procedimento, illustrato in prevede quindi applicare di figura 2B, soluzione 40 contenente nanoparticelle metalliche 37 semiconduttore 31, di ora sottostrato poroso, tramite un processo di precipitazione o nanoparticelle capillare. Le condensazione metalliche 37 penetrano per capillarità, all'interno mentre la matrice nanoporosa, pori della dei della soluzione evapora, dando frazione liquida luogo a un fenomeno di condensazione capillare.

Alternativamente, in luogo della precipitazione capillare, in luogo della precipitazione o condensazione capillare è possibile impiegare un metodo di deposizione elettrochimica per depositare le nanoparticelle metalliche 37 nei pori 22.

In un quinto passo viene poi eseguito un processo di annealing termico al fine di fondere o aggregare dette nanoparticelle metalliche in una struttura colonnare o nanorod 23, mostrato in figura 2C, e abbassarne la resistenza, ottenendo un

elemento magnetoresistivo 20 costituito da una matrice porosa di semiconduttore con pori 22 riempiti di materiale metallico.

del Secondo un ulteriore aspetto inventivo della sostituzione la procedimento proposto, soluzione elettrolitica 32 nel terzo passo con la soluzione 40 contenente le nanoparticelle metalliche avviene progressivamente senza scoprire superficie del sottostrato 31, lasciando cioè uno strato di elettrolita 32 sufficiente a coprire i pori 22, e a impedire quindi che l'aria o il gas ambiente vi penetri. Ciò renderebbe difficile la penetrazione in profondità delle nanoparticelle metalliche 37.

Successivamente, in un passo non mostrato nelle figure, quindi, l'elemento magnetoresistivo 20 viene provvisto di contatti laterali, analoghi a quelli mostrati in figura 1, tramite un processo di evaporazione metallica.

Le nanoparticelle metalliche possono essere di un qualsiasi metallo come oro, argento, alluminio, gallio, indio, rame, cromo, stagno, nichel, ferro, platino, palladio, cobalto, tungsteno, molibdeno, tantalio, titanio, permalloy, così come altre leghe ferromagnetiche o altre leghe con conduzione di tipo sostanzialmente metallico.

Il sottostrato di semiconduttore 31 può essere deposto su un altro substrato isolante qualsiasi e.g. silicio o vetro mediante i procedimenti più differenti quali elettrodeposizione continua o impulsata, metodi elettrochimici, precipitazione semplice, centrifugazione, evaporazione termica o electron beam, sputtering semplice o magnetron, CVD, PECVD, serigrafia.

La soluzione appena descritta consente di conseguire notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni note.

E' proposto un procedimento di fabbricazione di un dispositivo di rilevazione di campi magnetici, magnetoresistivo elemento equipaggiato con un comprendente regioni a conduzione metallica (13; 23) semiconduttiva, conduzione regioni vantaggiosamente prevede di adottare una struttura mesoscopica disordinata, con preparazione separata successiva nanoparticelle metalliche di applicazione ad un sottostrato di semiconduttore con processi semplici ed economici.

Naturalmente, fermo restando il principio del trovato, i particolari di costruzione e le forme di attuazione potranno ampiamente variare rispetto a quanto descritto ed illustrato a puro titolo di esempio, senza per questo uscire dall'ambito della presente invenzione.

In una possibile variante al procedimento di fabbricazione proposto, si può prevedere, al fine di realizzare un elemento magnetoresistivo con una struttura mesoscopica disordinata comprendente aree aree metalliche aventi diverse semiconduttive e del seconda conduzione a proprietà di magnetico applicato, in virtù del costituirsi di una zona di carica spaziale nelle aree metalliche a cagione della forza di Lorentz, di coevaporare dette nanoparticelle metalliche nell'ambito di un processo di crescita di un sottostrato di semiconduttore. Ad esempio, è possibile coevaporare delle particelle di crescita di di il processo durante oro sottostrato di antimoniuro di indio per Chemical Vapour Deposition o sputtering.

il realizzato tramite dispositivo Un procedimento descritto può essere impiegato sensore di campo magnetico o switch magnetico, come elettromagnetica, come radiazione di sensore radiazione elettromagnetica, come di emettitore cella fotovoltaica, e come cella termofotovoltaica.

* * * * * * * *

RIVENDICAZIONI

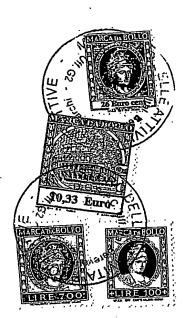
di di fabbricazione 1. Procedimento dispositivo di rilevazione di campi magnetici, detto comprendendo le operazioni procedimento fabbricare un elemento magnetoresistivo (10; 20) comprendente regioni a conduzione metallica (13; 23) regioni a conduzione semiconduttiva (11;31) caratterizzato dal fatto che detto procedimento comprende le seguenti operazioni:

-formare delle nanoparticelle metalliche (37)
per realizzare dette regioni a conduzione metallica
(13; 23);

-provvedere un sottostrato di semiconduttore (31);

-applicare dette nanoparticelle metalliche (37) a detto sottostrato di semiconduttore (31) per ottenere una struttura mesoscopica disordinata.

- 2. Procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto di sottoporre detto sottostrato di semiconduttore (31) a un processo di attacco chimico al fine di formare dei pori (22) in detto sottostrato di semiconduttore (31).
- 3. Procedimento secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto di applicare dette nanoparticelle metalliche (37) a detto sottostrato



di semiconduttore, introducendo dette nanoparticelle (37) in una soluzione (40) e applicando detta soluzione (40) a detto sottostrato (31).

- 4. Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che è impiegato iun procedimento di condensazione capillare di detta soluzione (40) nei pori (22) di detto sottostrato di semiconduttore (31) al fine di ottenere dette regioni metalliche (23).
- 5. Procedimento secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che è impiegato iun procedimento di deposizione elettrochimica nei pori (22) di detto sottostrato di semiconduttore (31) al fine di ottenere dette regioni metalliche (23).
- 6. Procedimento secondo almeno una delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che per eseguire detto processo di attacco chimico del sottostrato di semiconduttore (31) a detto sottostrato (31) è applicato un template poroso (38), in particolare un template di allumina porosa.
- 7. Procedimento secondo la rivendicazione 6, caratterizzato dal fatto che detto attacco chimico fa uso di una soluzione elettrolitica (32) atta ad attaccare detto sottostrato di semiconduttore (31) e che detta soluzione elettrochimica (32) è sostituita

progressivamente dalla soluzione (40) contenente nanoparticelle metalliche (37) lasciando sempre la superficie del sottostrato di semiconduttore (31) immersa, al fine di evitare la penetrazione di aria o gas ambiente in detti pori (22).

- 8. Procedimento secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, caratterizzato dal fatto che comprende inoltre un passo di annealing termico di detto elemento magnetoresistivo (20) al fine di creare dei nanorod in detti pori (22).
- 9. Procedimento secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto passo di provvedere un sottostrato di semiconduttore prevede di crescere detto sottostrato (31) tramite un processo di crescita e il passo di applicare dette nanoparticelle metalliche (37) prevede di coevaporare dette particelle (37) durante detto processo di crescita di detto sottostrato (31).
- 10. Procedimento secondo la rivendicazione 9,

 <u>caratterizzato dal fatto che</u> detto processo di

 crescita è un processo di sputtering
- 11. Procedimento secondo la rivendicazione 9, caratterizzato dal fatto che detto processo di crescita è un processo di Chemical Vapour Deposition.

- Procedimento secondo almeno delle una 12. rivendicazioni da 1 a 11, caratterizzato dal fatto che detto sottostrato di materiale semiconduttore (31) è realizzato tramite un semiconduttore scelto germanio, antimoniuro di silicio, fra tellururo di mercurio, arseniuro di indio, titanato di gallio, carburo carbonio, arseniuro di silicio, fosfuro di gallio, nitruro di gallio e allumina.
- secondo almeno una delle Procedimento 13. rivendicazioni da 1 a 12, caratterizzato dal fatto che dette nanoparticelle metalliche (37) sono di un metallico scelto fra oro, argento, materiale indio, rame, cromo, stagno, alluminio, gallio, ferro, platino, palladio, cobalto, nichel. tungsteno, molibdeno, tantalio, titanio, permalloy.
- 14. Procedimento secondo una o più delle rivendicazioni precedenti, <u>caratterizzato dal fatto</u> di deporre detto sottostrato di semiconduttore (31) su un altro sottostrato isolante.
- 15. Procedimento secondo almeno una delle rivendicazioni da 2 a 14, <u>caratterizzato dal fatto che</u> detta processo di attacco chimico al fine di formare dei pori (22) nel sottostrato di semiconduttore (31) forma dei pori (22) passanti.

- campi rilevazione di di Dispositivo 16. che comprende un elemento tipo del magnetici, magnetoresistivo (10; 20) atto a variare la propria resistenza in corrispondenza dell'applicazione di un campo magnetico (H), caratterizzato dal fatto che detto elemento magnetoresistivo (20) è fabbricato secondo il procedimento secondo le rivendicazioni da 1 a 14.
- 17. Dispositivo secondo la rivendicazione 16 caratterizzato dal fatto che detti elettrodi (14) sono applicati alle superfici laterali di detto elemento magnetoresistivo (20) per applicare una corrente (I).

Il tutto sostanzialmente come descritto ed illustrato e per gli scopi specificati.

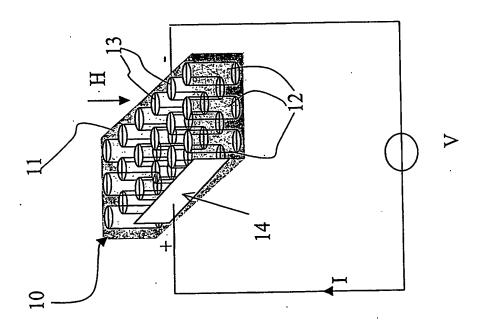
Ing. Gioncarlo / TARO N. jscylz. Akto 258 (In proprio e per gli eliri)

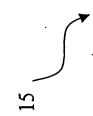
10,33 Euroc



TO 2003 A 000605



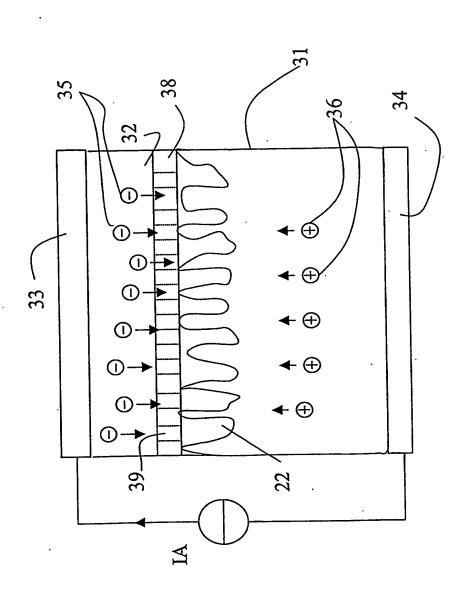






Ing. Glancorlo MOTARO N. lycryz (ALEO 258 In proppo e per gli alini)

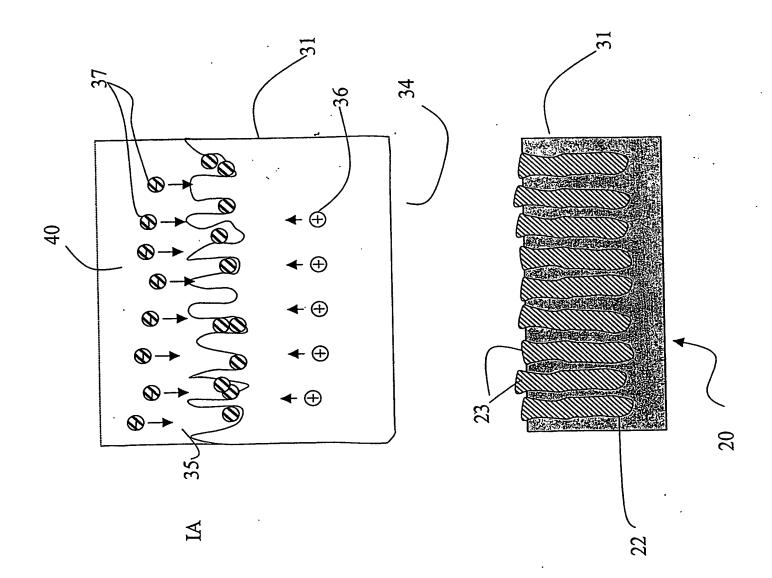
Fig. 2A



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Ing. Giancorlo 120TARO N. lat. 12 (2) 258 I la proposo e per gli elidi Fig. 2B

Fig. 2C



EAMERA DI GOMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOITURA DI TORINO

Ing. Glendorlo NOTARO
N. Archis. Aley 258
He people of the gli alini

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

beleets in the images metade but are not imitted to the items effected.
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.